



決算説明会

2022年3月期 上半期決算

2021年10月29日
ローム株式会社
代表取締役社長 松本 功

■ 2022年3月期 業績報告

業績報告

売上の変動要因

営業利益の増減分析

市場別売上推移

■ 設備投資の状況

■ 在庫の状況

■ 株主還元

■ ロームの戦略

2022年3月期 上半期 実績 業績報告 (前年比)



(単位：億円)

	'22/3期 上半期 実績	'21/3期 上半期 実績	増減額	前年比
売上高	2,226	1,680	+546	+32.5%
営業利益	345	126	+219	+172.0%
(対売上比率)	(15.5%)	(7.5%)	-	-
経常利益	378	117	+261	+220.9%
(対売上比率)	(17.0%)	(7.0%)	-	-
純利益	308	125	+183	+145.9%
(対売上比率)	(13.8%)	(7.5%)	-	-
EBITDA	534	320	+214	+66.7%
(対売上比率)	(24.0%)	(19.1%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (110.18円) (106.74円)

2022年3月期 上半期 実績 業績報告 (5月10日公表値比)



(単位：億円)

	'22/3期 上半期 実績	'22/3期 上半期 計画	増減額	計画比
売上高	2,226	2,100	+126	+6.0%
営業利益	345	310	+35	+11.3%
(対売上比率)	(15.5%)	(14.8%)	-	-
経常利益	378	290	+88	+30.6%
(対売上比率)	(17.0%)	(13.8%)	-	-
純利益	308	205	+103	+50.3%
(対売上比率)	(13.8%)	(9.8%)	-	-
EBITDA	534	515	+19	+3.8%
(対売上比率)	(24.0%)	(24.5%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (110.18円) (105.82円)

2022年3月期 通期 業績予想 (期初計画比、前年比)



※今回 修正発表

(単位：億円)

	'22/3期 修正計画	'22/3期 期初計画	'21/3期 通期 実績	期初計画比	前年比
売上高	4,400	4,000	3,598	+10.0%	+22.3%
営業利益	630	490	384	+28.6%	+63.7%
(対売上比率)	(14.3%)	(12.2%)	(10.7%)	-	-
経常利益	660	480	406	+37.5%	+62.3%
(対売上比率)	(15.0%)	(12.0%)	(11.3%)	-	-
純利益	510	340	370	+50.0%	+37.8%
(対売上比率)	(11.6%)	(8.5%)	(10.3%)	-	-
EBITDA	1,067	962	786	+10.9%	+35.7%
(対売上比率)	(24.2%)	(24.0%)	(21.9%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$)

(110.10円)

(105.44円)

(106.20円)

2022年3月期 上半期 市場別 売上の変動要因 (前年比)



(単位：億円)

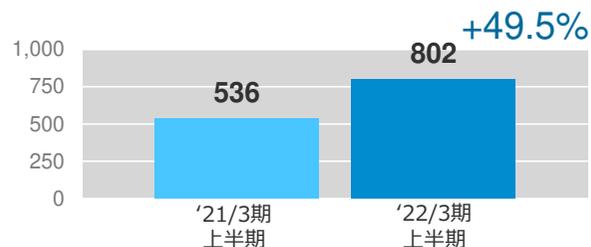
上半期売上高

1,680億円 **+32.5%**
2,226億円

'21/3期 上半期
実績

'22/3期 上半期
実績

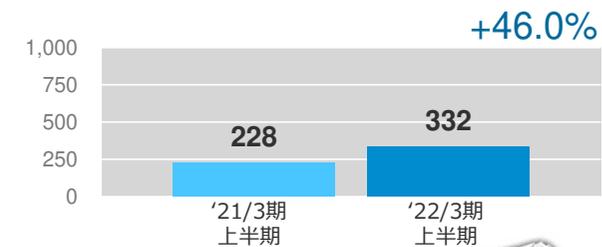
車載



- インフォテインメント分野 (オーディオ/ナビ/パネル) +127 (+51)
- パワートレイン分野 +77
- ADAS分野 +19
- ボディ分野 +42



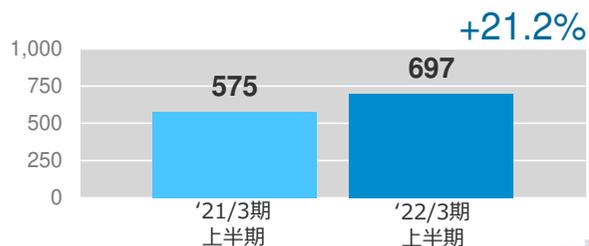
産機



- FA分野 +50
- エネルギー分野 +5
- インフラ分野 +2
- その他 +48



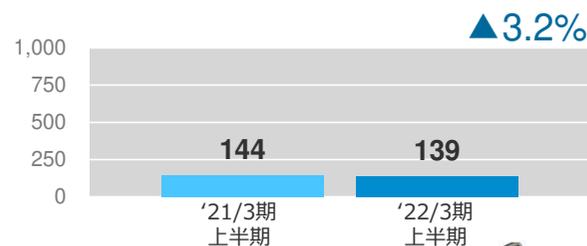
民生



- 家電分野 +47
- AV関連 +36
- その他 +39



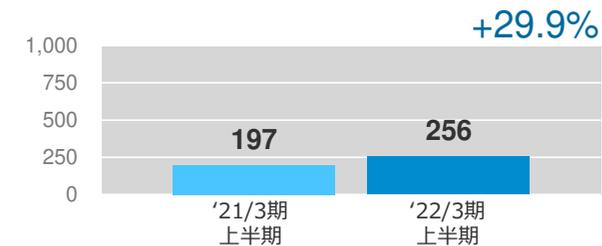
通信



- 通信分野全般 ▲5



事務機



- PC、OA機器分野 +46
- 決裁端末向け +13



2022年3月期 通期 市場別 売上の変動要因 (前年比)



(単位：億円)

通期売上高

3,598億円 (+22.3%)
4,400億円

'21/3期 通期
実績

'22/3期 通期
修正計画

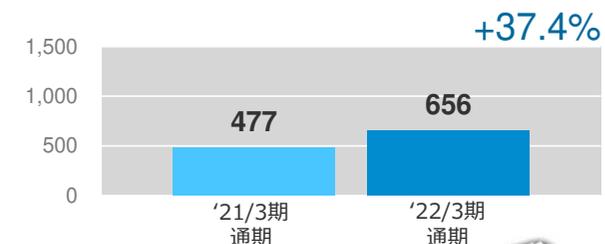
車載



- インフォテインメント分野 (オーディオ/ナビ/パネル) +177 (+72)
- パワートレイン分野 +125
- ADAS分野 +24
- ボディ分野 +55



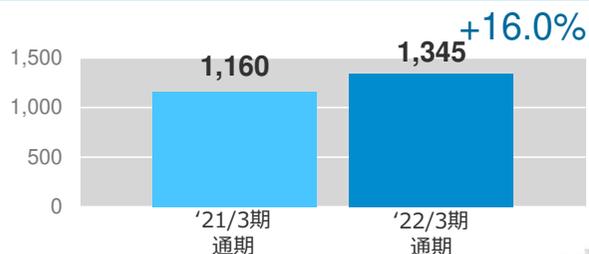
産機



- FA分野 +93
- エネルギー分野 +11
- インフラ分野 +2
- その他 +72



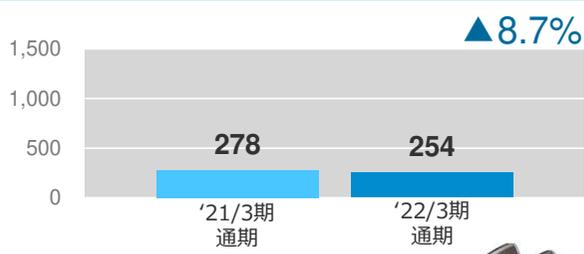
民生



- 家電分野 +65
- AV関連 +42
- その他 +78



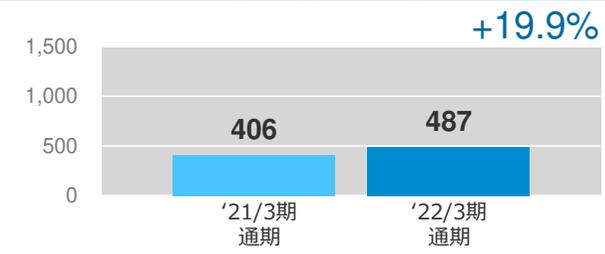
通信



- 通信分野全般 ▲24



事務機



- PC、OA機器分野 +64
- 決裁端末向け +17

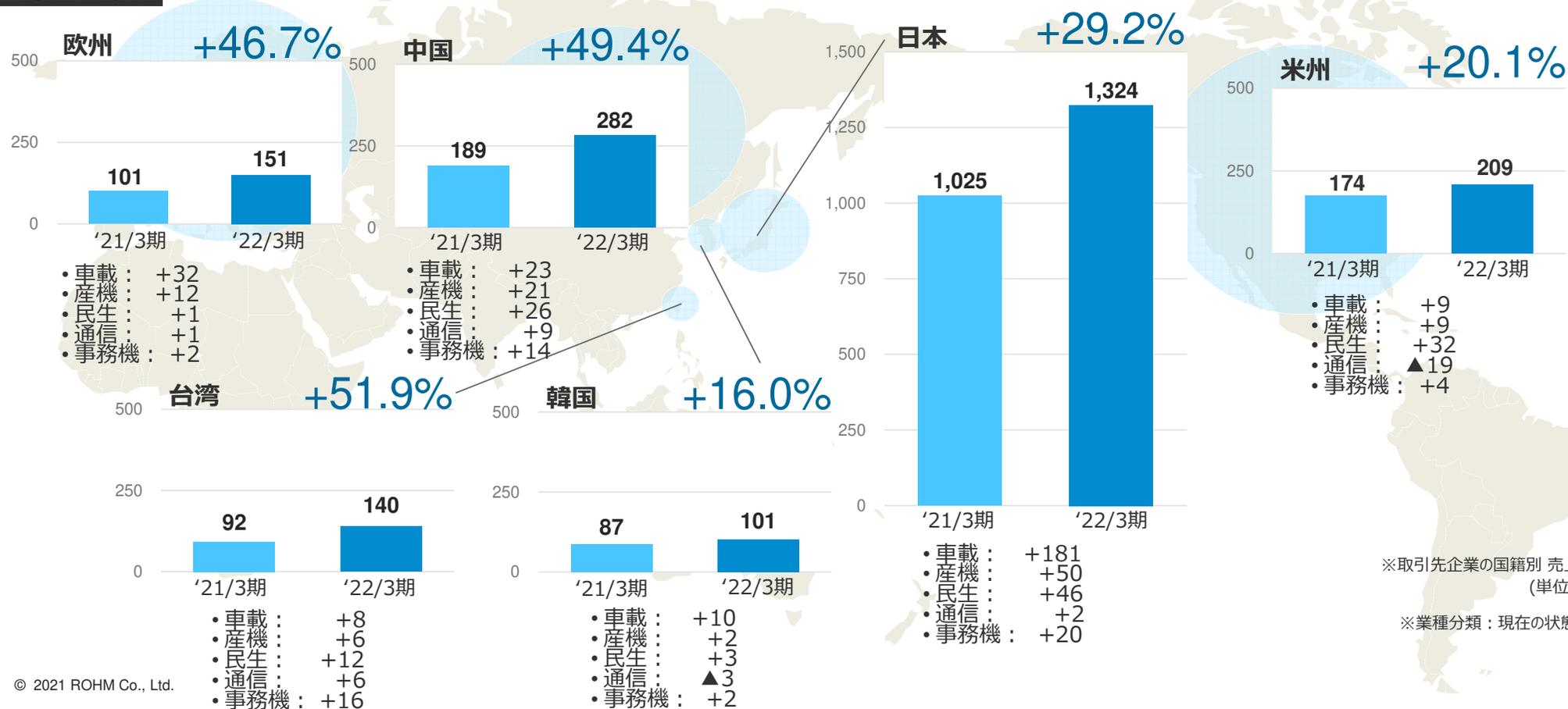


2022年3月期 上半期 国籍別 売上の変動要因 (前年比)



上半期売上高 **1,680億円** ('21/3期 上半期 実績) **2,226億円** ('22/3期 上半期 実績) **+32.5%**

上半期前年比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

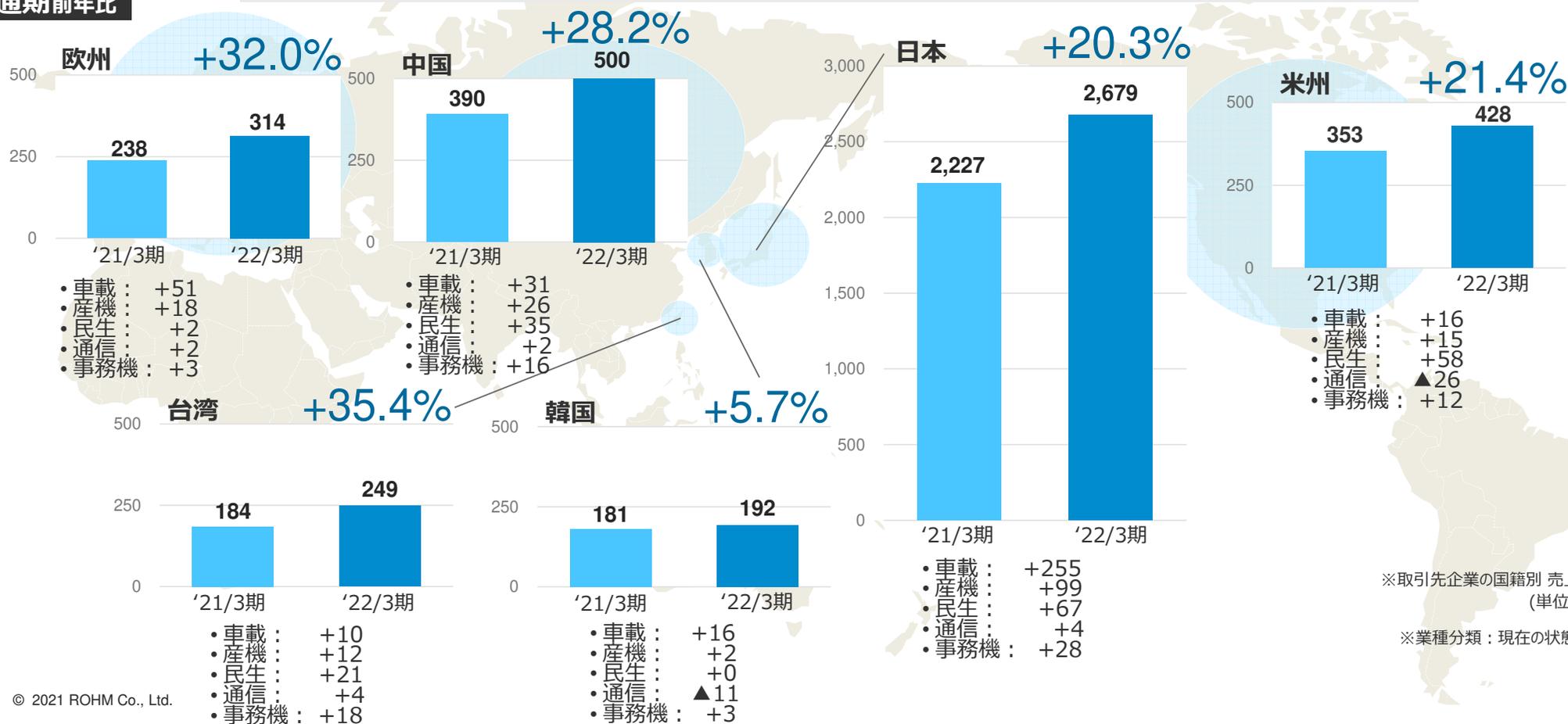
※業種分類: 現在の状態で集計

2022年3月期 通期 国籍別 売上の変動要因 (前年比)



通期売上高 **3,598億円** ('21/3期 通期 実績) **4,400億円** ('22/3期 通期 修正計画) **+22.3%**

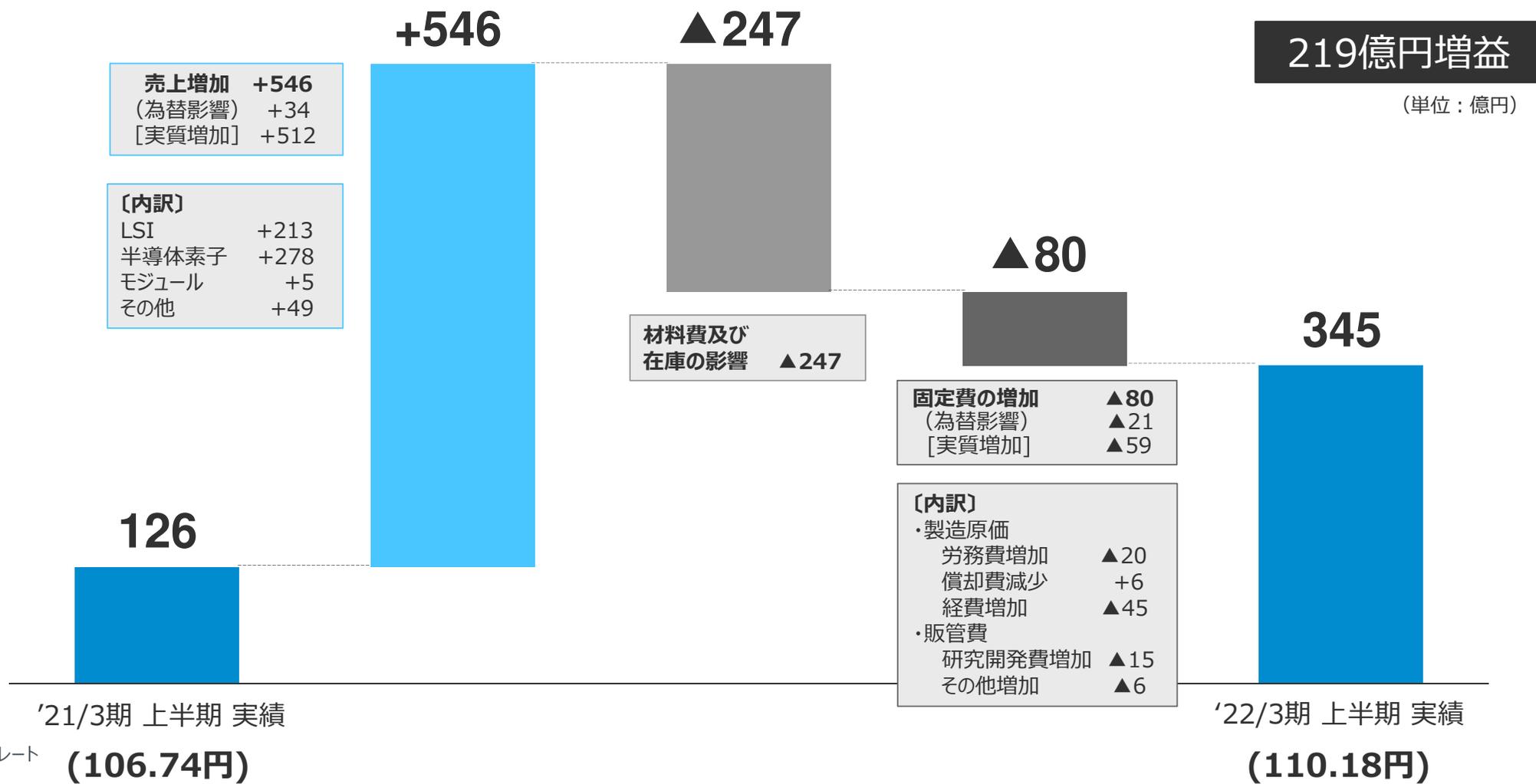
通期前年比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

※業種分類: 現在の状態で集計

上半期 営業利益 増減分析 (前年比)



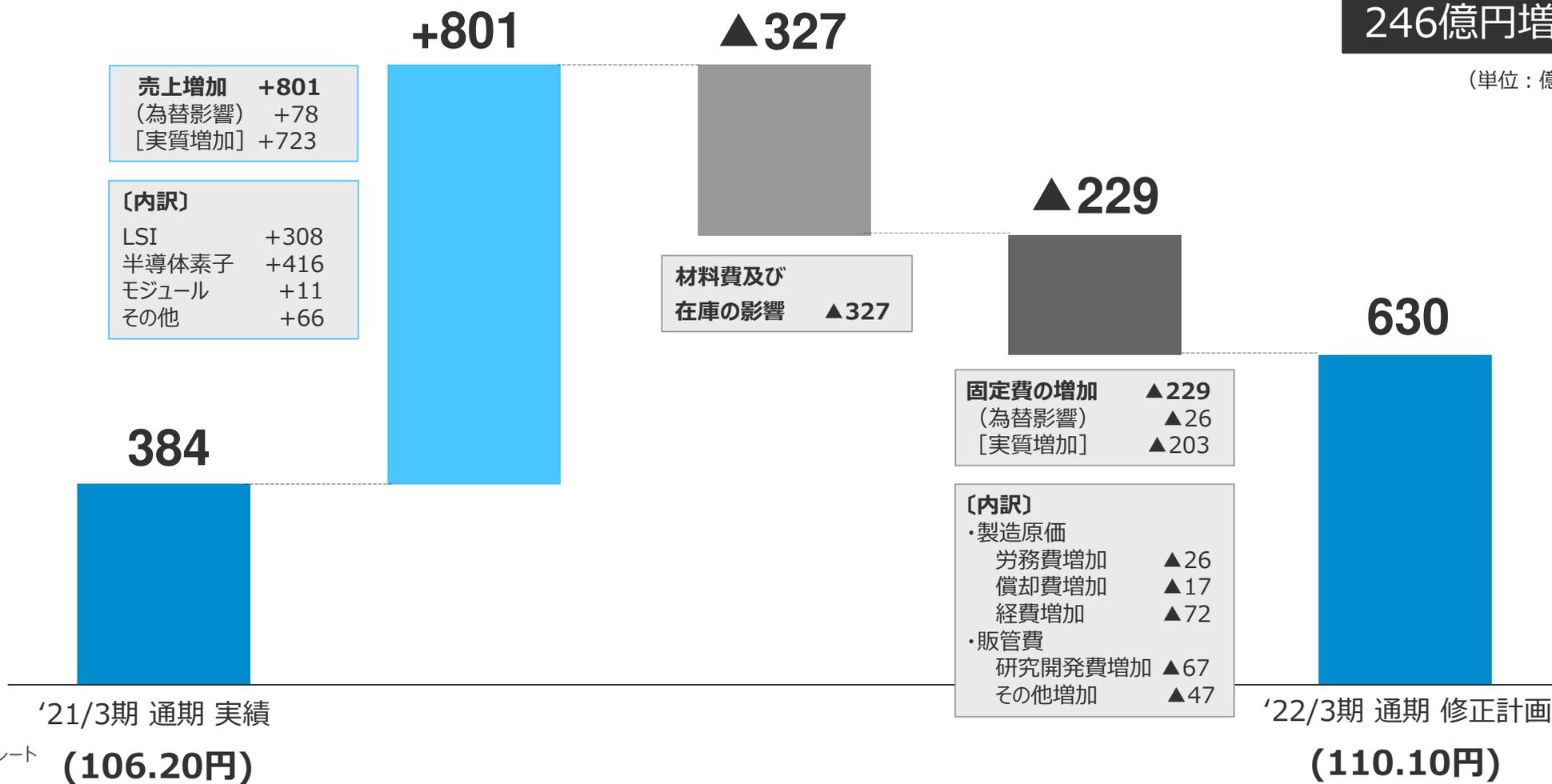
期中平均レート (¥/US\$) **(106.74円)**

通期 営業利益 増減分析 (前年比)



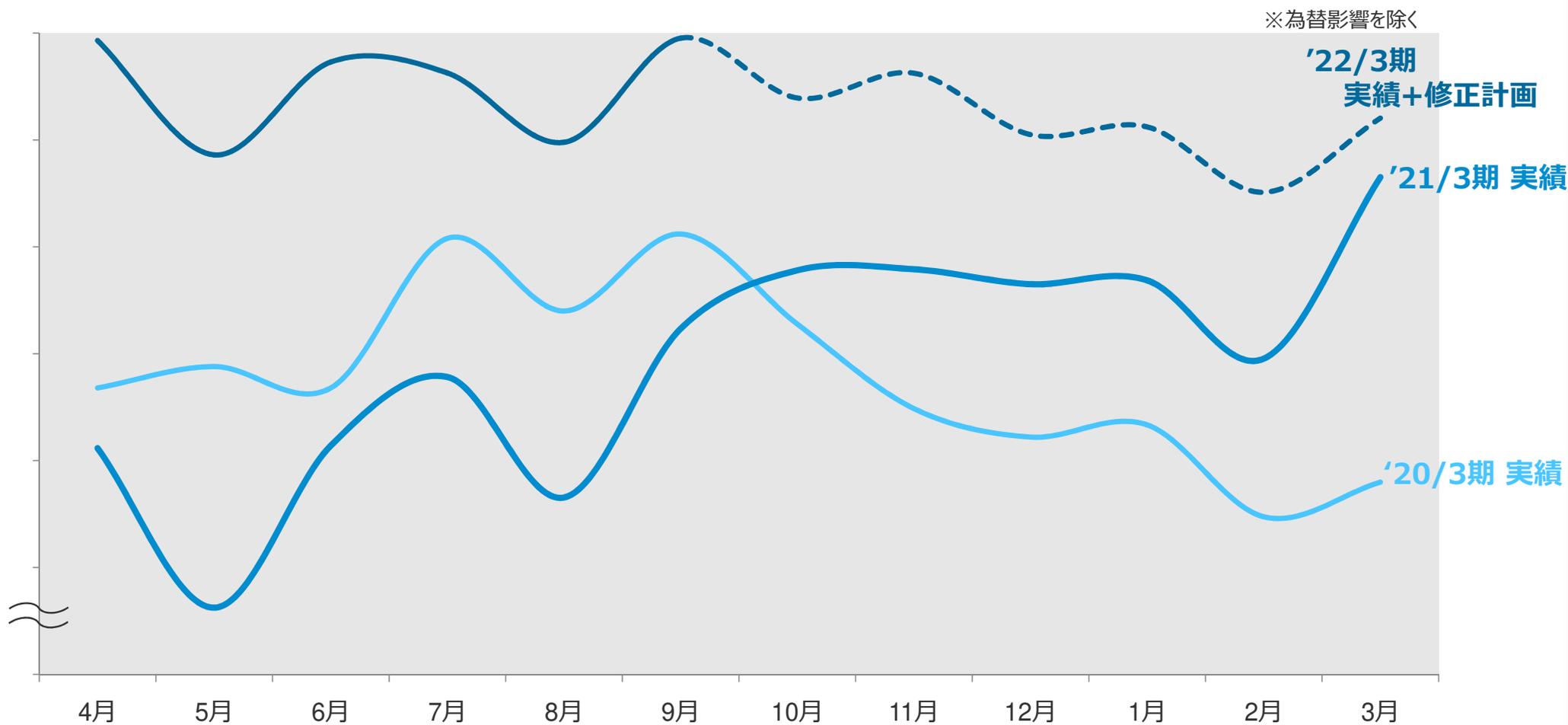
246億円増益

(単位：億円)

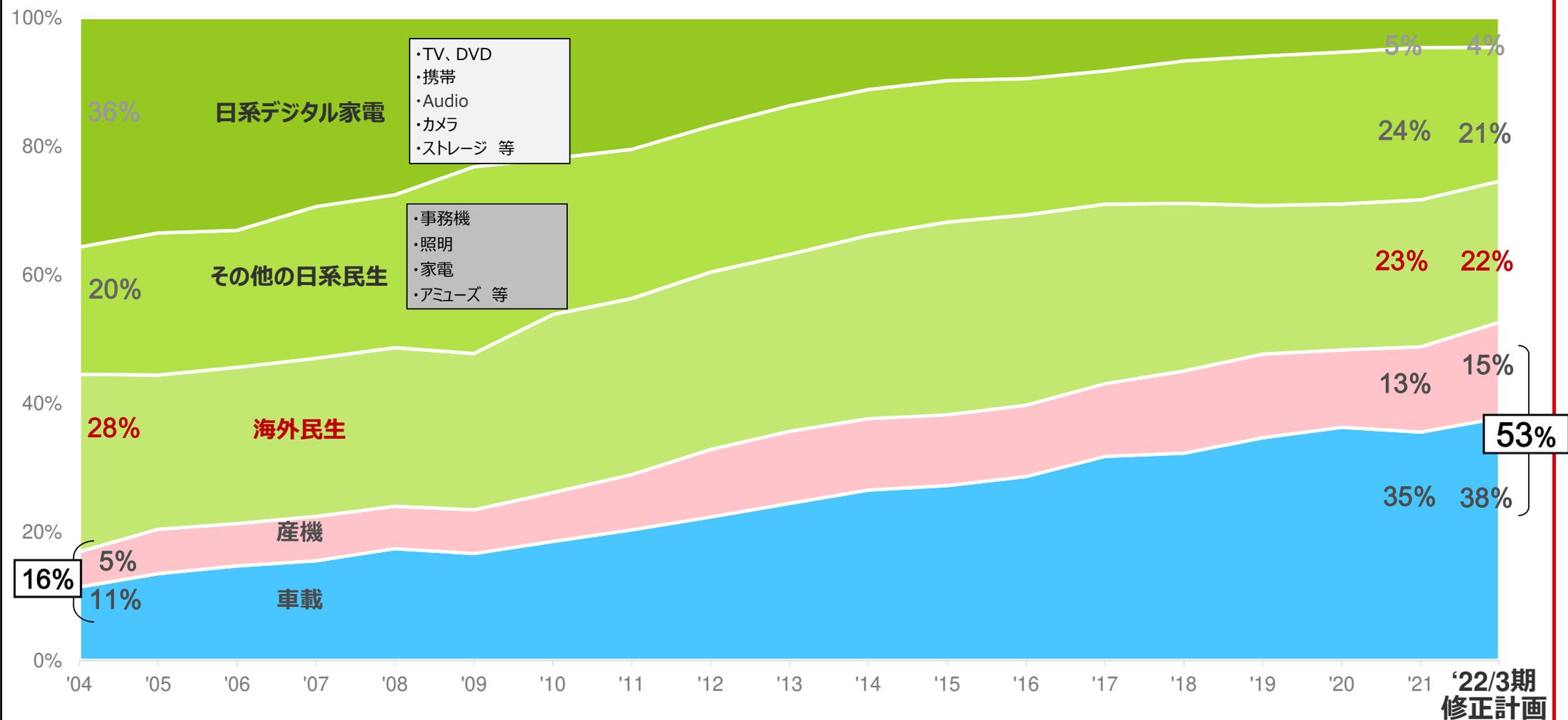


期中平均レート (¥/US\$) **(106.20円)**

売上トレンド



市場別売上構成比推移



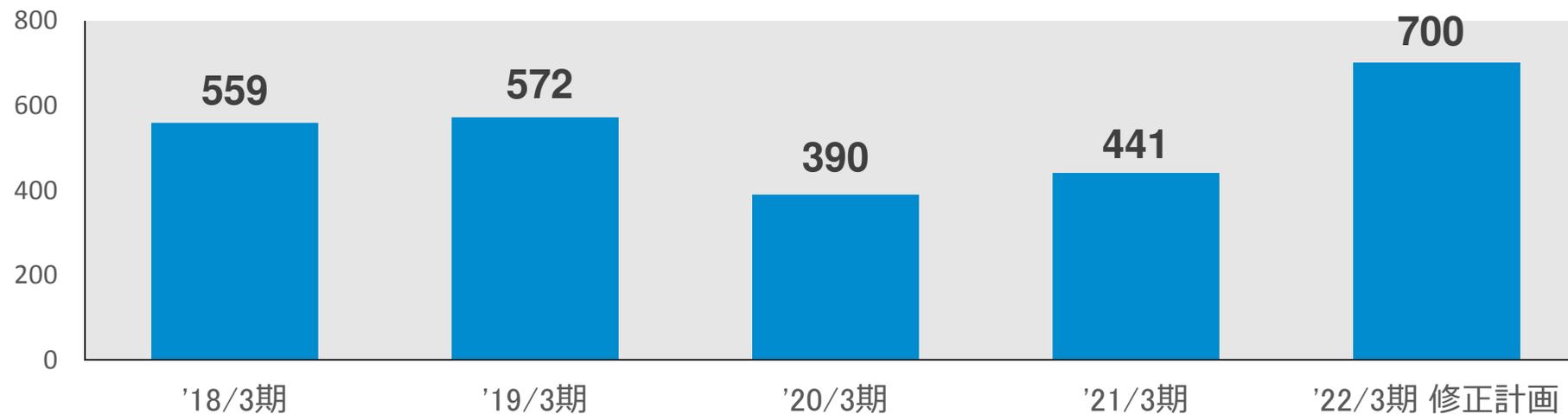
設備投資の状況



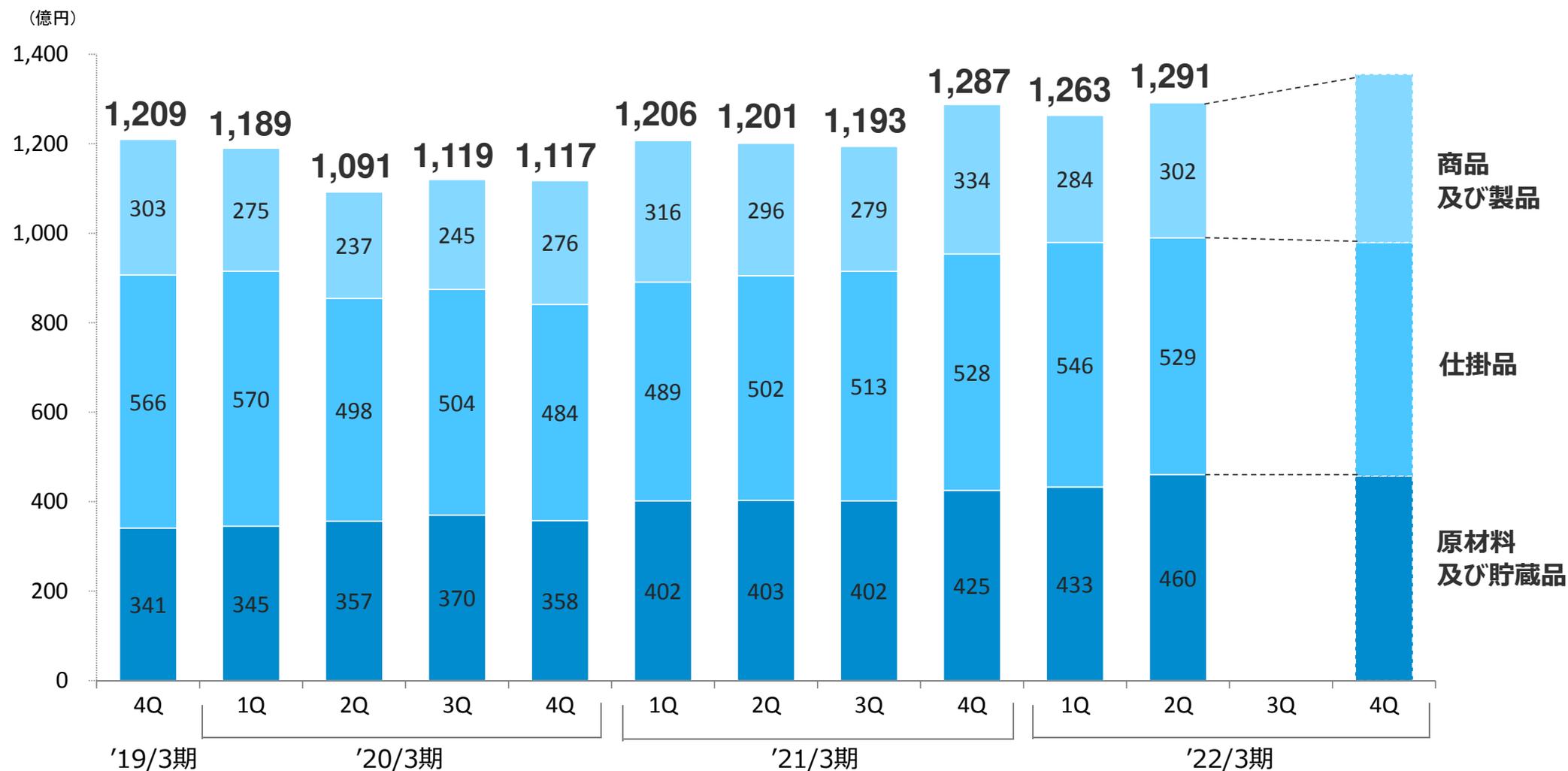
(億円)	合計	生産能力 向上	土地・建物	品質向上	その他
'20/3期 実績	390	171	85	25	109
'21/3期 実績	441	122	160	27	132
'22/3期 上期実績	272	174	41	6	51
'22/3期 通期修正計画	700	377	157	31	135

(億円)

設備投資の推移



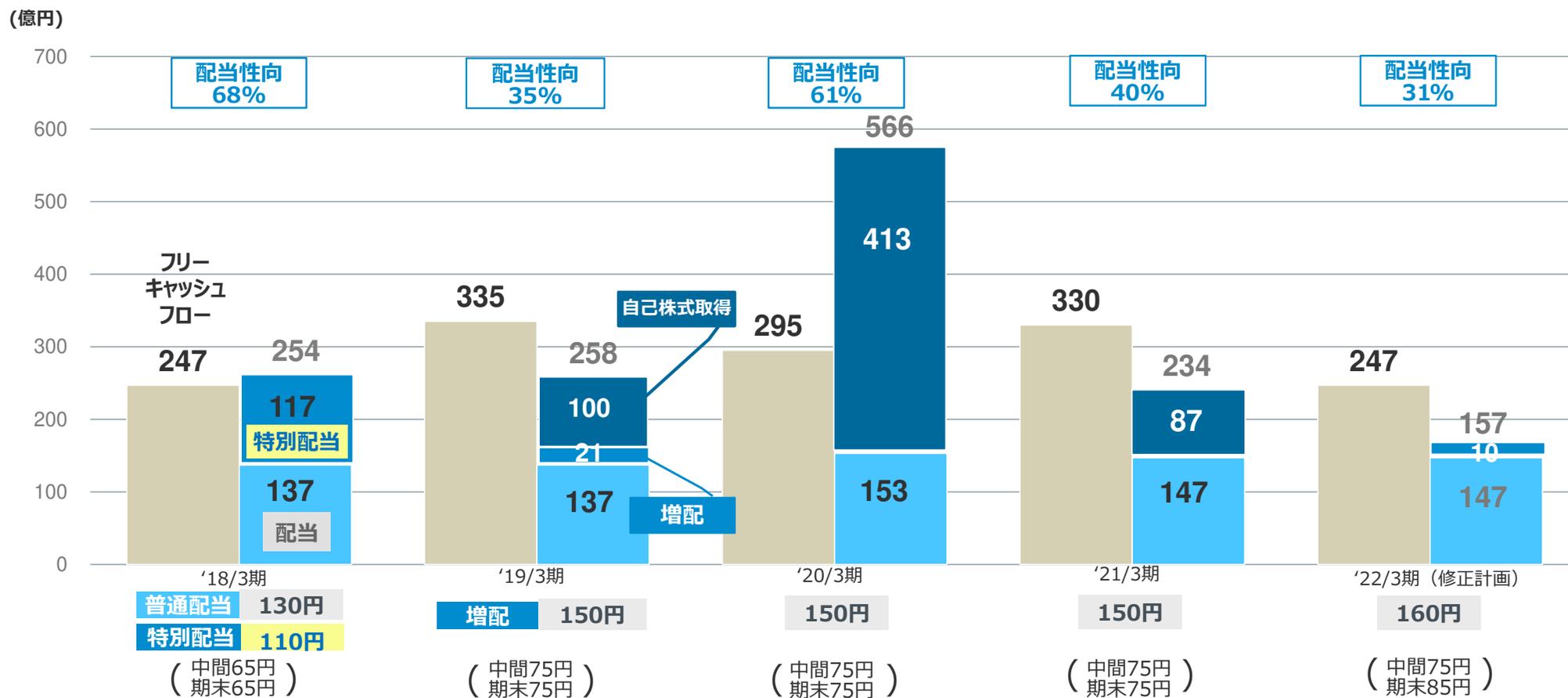
在庫の状況（金額）



株主還元 (フリーキャッシュフローと株主還元の推移)



①今後の政策保有株の縮減、②現在の株式市場の動向、③中長期業績見通し 左記を総合的に考慮し、自社株買い、特別配当等の追加還元策を実施。
 従来からの財務政策、株主還元策については、変更なし。(事業成長の為の積極投資、連結配当性向30%以上、極力減配を避けるなど)



経営ビジョン

パワーとアナログにフォーカスし、
お客様の "省エネ"・"小型化" に寄与することで、社会課題を解決する

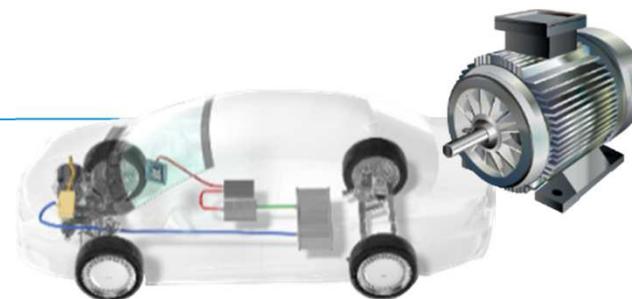
LSI	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高性能汎用ASSPを軸に商品開発を進める ・ PMEを軸として市場成長を加速させるASSPで商品展開
パワーデバイス 小信号デバイス	<ul style="list-style-type: none"> ・ パワーデバイス事業：トップラインを上げ中核事業に成長 ・ 小信号デバイス事業：キャッシュカウ事業としてトップシェアを維持
モジュール その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車載・産機を中心に独自技術を活かした高付加価値商品の開発
研究開発・新規事業創出	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既存事業の強化、新規事業の種蒔きのためのCVC活動
モノづくり	<ul style="list-style-type: none"> ・ 組立工程の生産性向上&自動化を加速 ・ 京都本社にモノづくりイノベーションセンター設立 ・ 前工程の大口径化
営業・拡販体制	<ul style="list-style-type: none"> ・ SSE本部のソリューション提案による拡販力強化 ・ マーケティング・オートメーションの確立

高性能汎用ASSPを軸に商品開発を進める 特徴あるオリジナル プロセス・回路技術を強みに商品展開

パワーソリューション

絶縁ゲートドライバ

独自のコレクタレス技術を実装。電源/温度モニタ/保護回路などを集積化。PKGを含めた独自設計により、高ノイズ耐性、高信頼性を実現。



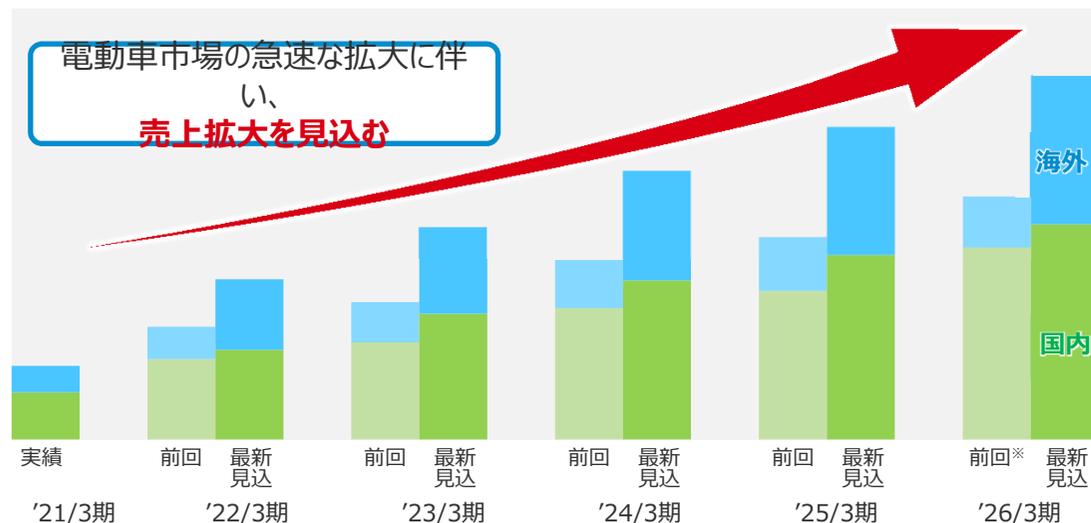
- 国内大手ユーザ向けトップシェア維持。米・中ユーザ向けにシェア大幅拡大。

- 20pin, 28pinに加え、38pinパッケージをラインアップ。更なる多機能化。



- 今後の数量増に対応するため、全開発機種8インチ→12インチ化。

※前回='21/3期 中間決算発表時



PMEを軸として市場成長を加速させるASSPで商品展開 特徴のあるプロセス・回路技術が強みにして高成長を実現

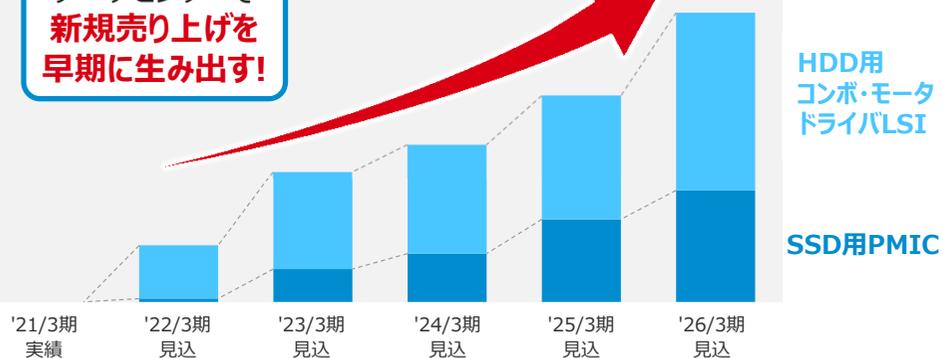
ストレージ向けLSI

データセンターに特化したHDDコンボLSIとSSD PMIC
PMEによる顧客需要の取り込みで勝ちぬく商品企画
高効率・長期信頼性を実現し、22年量産見込み。



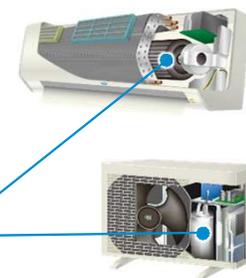
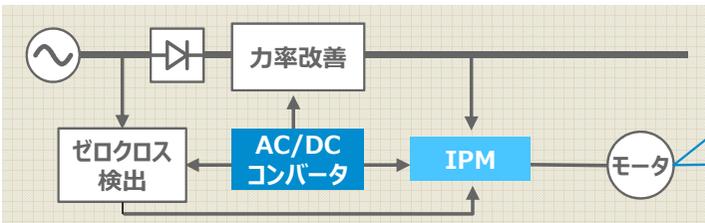
*SSD : Solid-State-Drive メモリーを使った記憶装置
*PMIC : Power Management LSI 複合電源管理LSI

データセンターで
新規売り上げを
早期に生み出す!

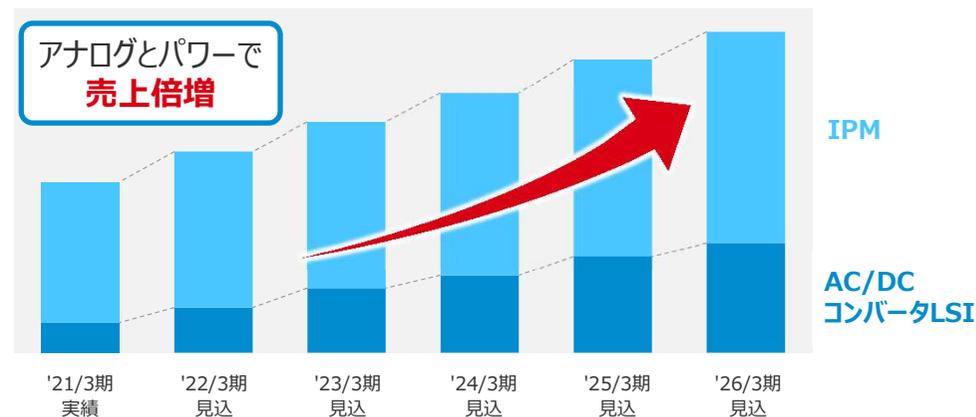


省エネ家電ソリューション

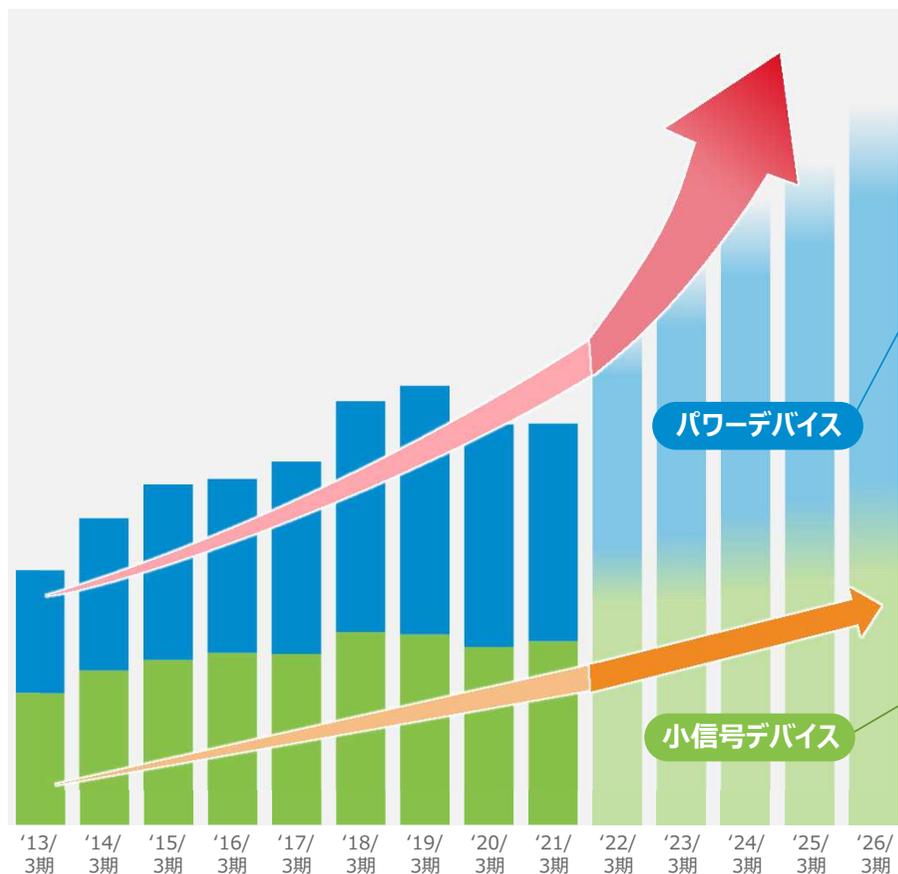
成長する中国/インド/アセアン 家電市場に対して
“省エネ”・“小型化” でシェア拡大見込み。



アナログとパワーで
売上倍増



パワー/小信号デバイス売上推移



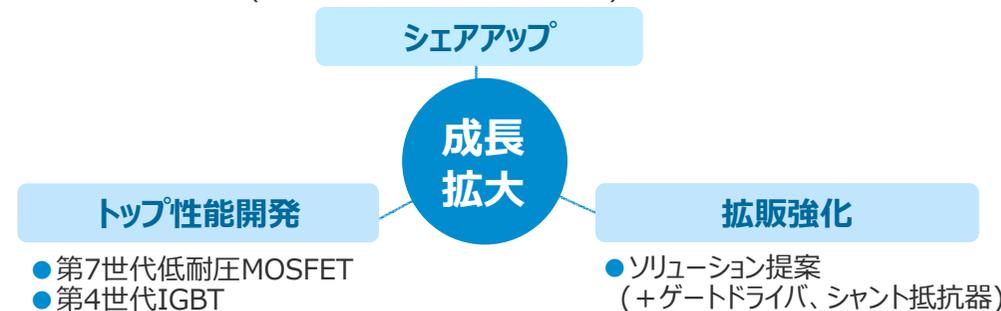
© 2021 ROHM Co., Ltd.

パワーデバイス事業

※Omdiaデータに基づいた企業分析

トップラインを上げ中核事業に成長

- WWシェア(2020年⇒2025年) 8位⇒5位※
(国内半導体メーカーとして4位⇒2位)※



小信号デバイス事業

キャッシュカウ事業としてトップシェアを維持

- 在庫設計の見直し
- 平準化生産



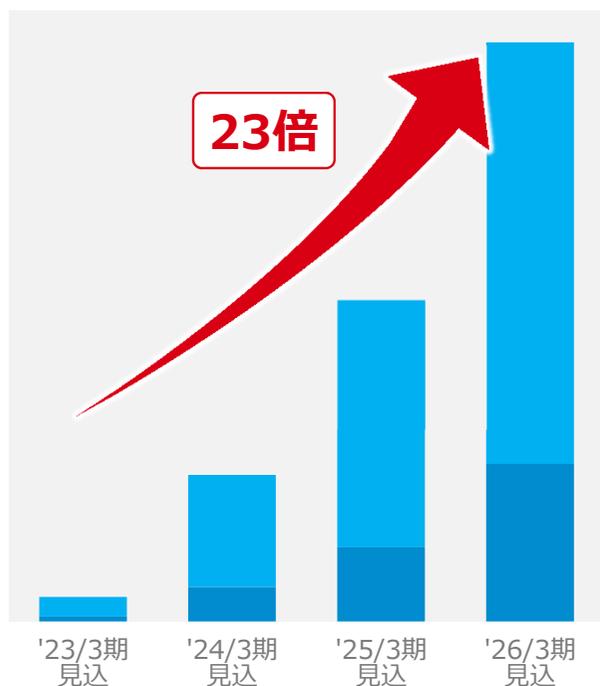
半導体素子事業戦略②：SiCパートナーシップ



新商品の第4世代SiC MOSFETは、主機インバータなど電動車を中心に採用案件が着実に増加

主機インバータ向けビジネス案件金額

■ パートナー締結案件 ■ パートナー以外案件



豊富な車載実績により
パートナー締結 拡大

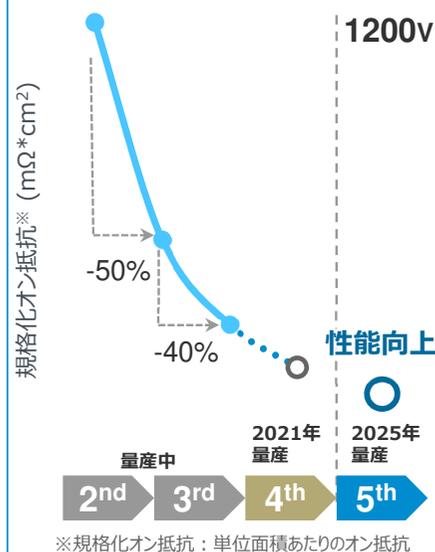
- HAIMOSIC** 海姆希科: パワーモジュール 合併企業
- GEELY**: 戦略的 パートナーシップ
- vitesco TECHNOLOGIES**: 優先サプライヤー認定 開発パートナーシップ
- UAES**: 優先サプライヤー認定 共同実験室
- LEADRIVE**: 共同研究所

23/3期を1とする

Why ROHM?

業界をリードする 技術開発力

2012年: **世界初**
車載準拠 SiC SBDリリース
2018年: **世界初**
車載準拠 SiC Trench MOSリリース



一貫生産体制による 強固なQCDS提供

材料



デバイス



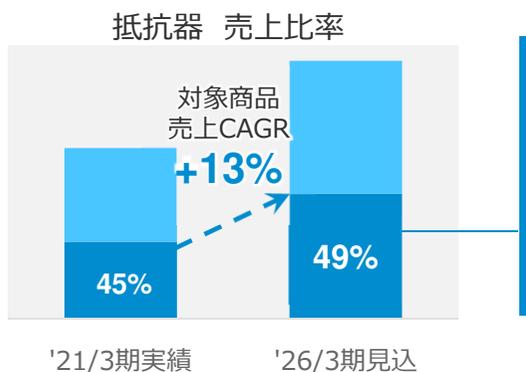
製品



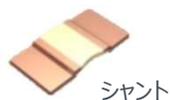
生産設備

車載・産機市場を中心に独自技術の強みを活かし、高付加価値商品をタイムリーに開発

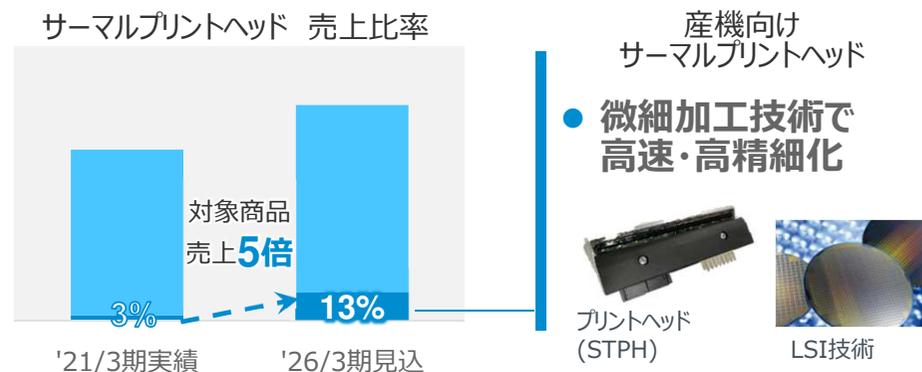
抵抗器



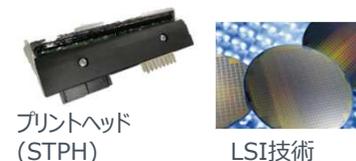
- 車載向け特殊抵抗
- 高放熱技術でハイパワー化



プリントヘッド

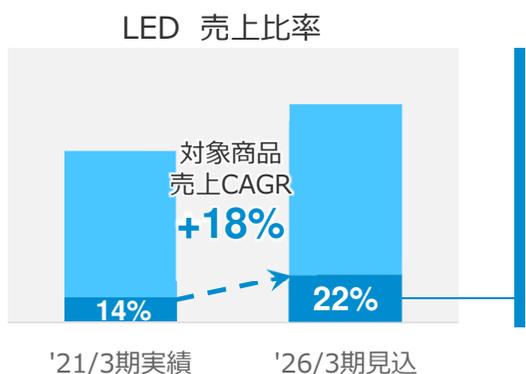


- 産機向けサーマルプリントヘッド
- 微細加工技術で高速・高精細化



LED

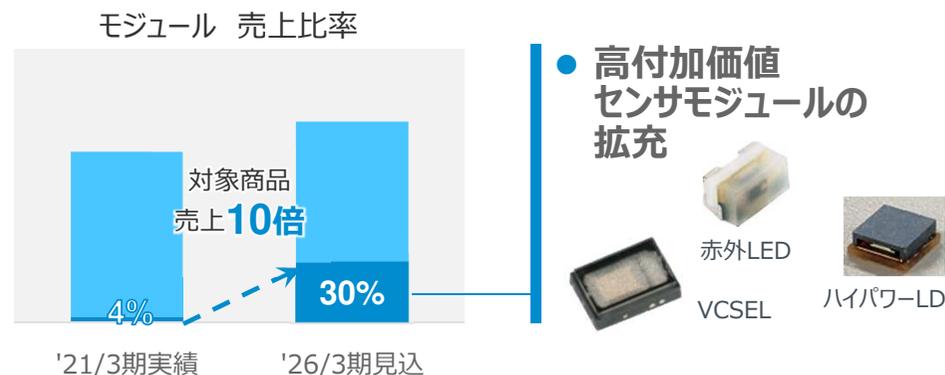
売上('21/3期:100)



- 車載向けLED
- 小型で高光度
 - 一貫生産で色ばらつき低減



センサモジュール

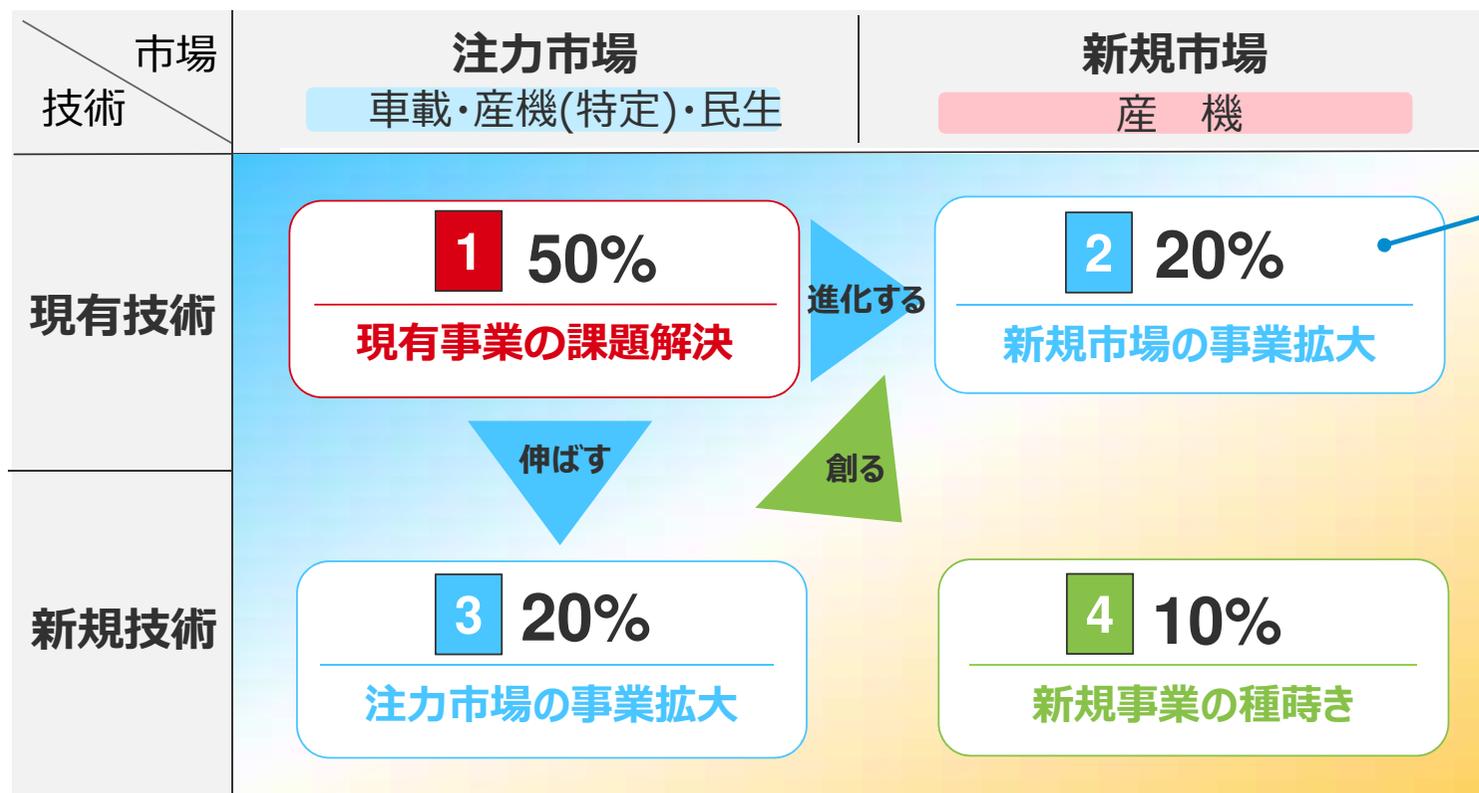


- 高付加価値センサモジュールの拡充



**MOVING FORWARD to 2025 中期経営計画以降の持続的な成長実現のため
既存事業の強化・新規事業の種蒔きのための施策の1つとしてスタートアップ企業との協業活動を強化する**

【社内外のR&Dリソース配置の考え方】



投資実績

- 直接投資
 - Locix, Inc.
(共同開発パートナー)
- VCファンドLP出資
 - Monozukuri Ventures
 - みらい創造機構
MIRAI SOUZOU
(株)みらい創造機構

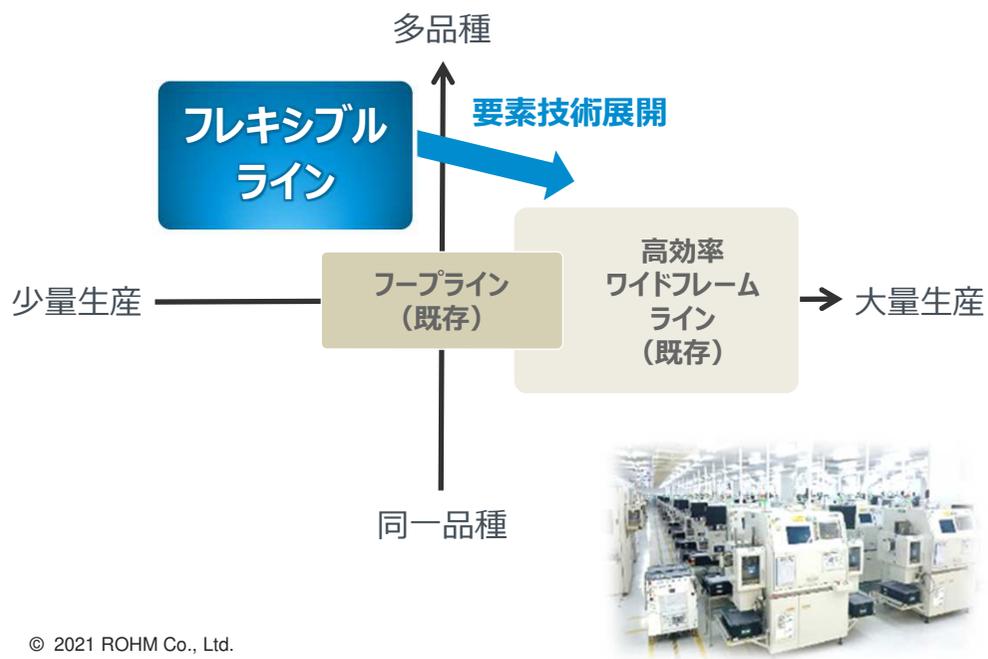
世界初の無人化生産ラインを実現！

組立工程の生産性向上 & 自動化を加速

フレキシブルライン量産開始

2021年4月～汎用デバイス生産、機種拡大中

国内マザー工場からの多品種供給により、BCP対応力強化



今後の展開

- 生産対応商品の拡大
LSI、パワーデバイスへ 2021年度～2023年度
- 国内マザー工場への増設展開
国内生産体制の増強によるサプライチェーン強靱化 2022年度～2023年度
- 海外工場への大量生産ラインへ展開 2024年度～

モノづくり：後工程②



ロームグループの技術力を集結し、人手に頼らない、不良を作らない、完全自動化、無人化を目指して、モノづくり改革を続けていく

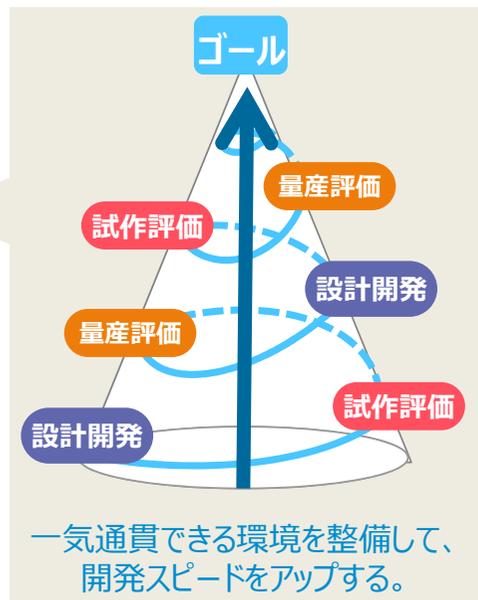
京都本社に 2023年12月竣工

ONE ROHM

<モノづくりイノベーションセンター設立>



モノづくりの起点となるコア技術開発者から、現場経験のある製造技術者まで、1 拠点に集結させる。人員も増強予定。

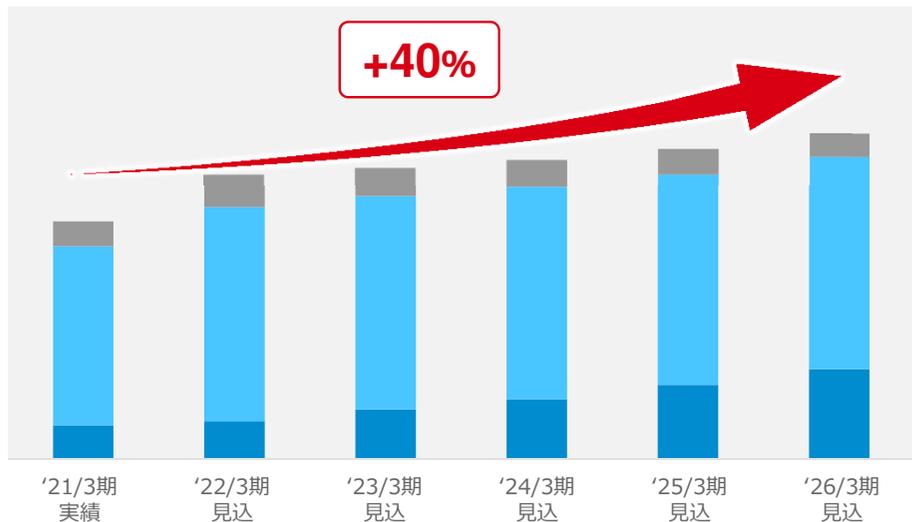


モノづくり：前工程 大口径化による生産能力アップ



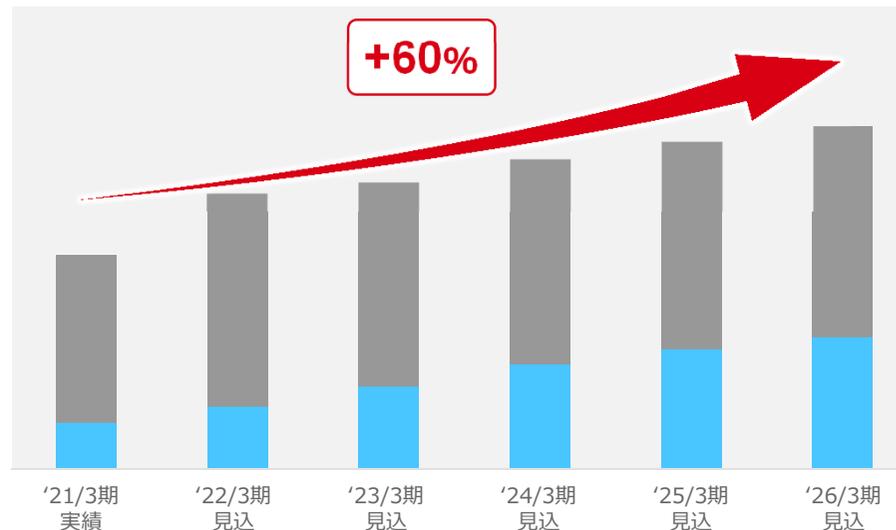
LSI生産量（面積換算）

■6インチ ■8インチ ■12インチ



半導体素子生産量（面積換算）

■6インチ ■8インチ



TOPIC 浜松工場 12インチ増強



'21年3月期比
 '23年3月期 **+33%**
 '26年3月期 **+110%**

キャパアップ

※ファンダリーも併用

TOPIC 滋賀工場 8インチ増強



'21年3月期比
 '23年3月期 **+50%**
 '26年3月期 **+150%**

キャパアップ

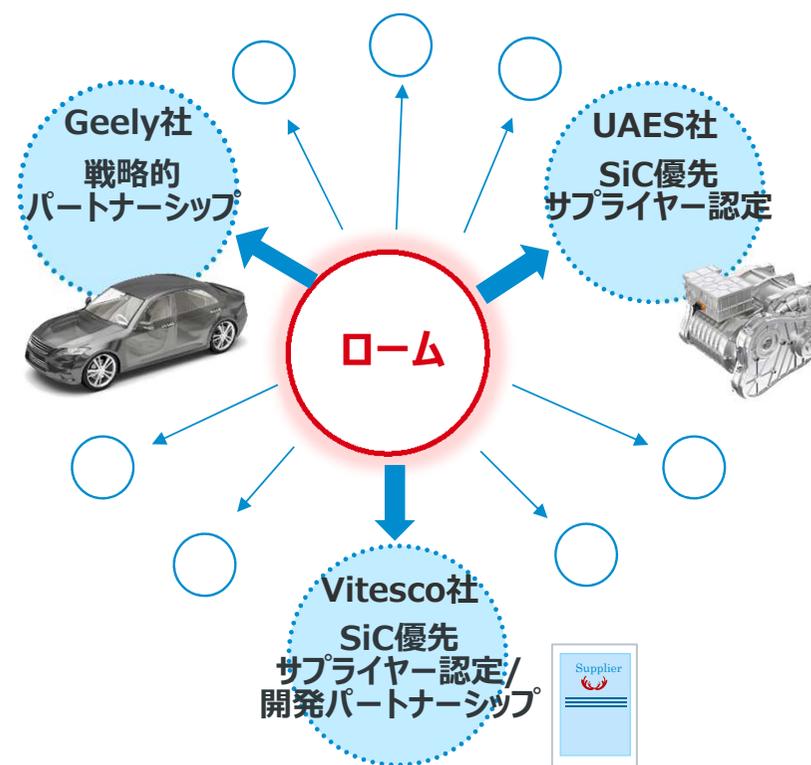
SSE本部のソリューション提案による拡販力強化



顧客アプローチをSSEが実施

- ソリューション提案
- アプリケーション提案
- グローバルアプリケーションセンター設立
(リファレンスデザインのリリース)

海外を主とする10社程度の顧客と アライアンス成約推進



マーケティング・オートメーションを確立させる

Web上で顧客設計が完結する環境を用意

世界水準のモデル/ツール

- ・**ROHM Solution Simulator**
⇒パワーデバイスとICを一括検証可能なシミュレーション・ツール提供
- ・**SPICEモデル**
⇒IC~ディスクリートまでを提供
- ・**ハイパワーデバイス**
⇒業界標準のシミュレーション・モデルを提供
- ・**ソリューション回路規模での熱解析をWeb上で提供**
- ・**リファレンスデザインで熱設計/EMC設計を提供**



デジタルマーケティングにより 新常態下での顧客コンタクト増大

- ・**特定顧客向けVirtual展示会**
⇒30社へ増加
面識のない方のリードを獲得
- ・**得意先限定のメールマガジン強化**
⇒67社配信
お客様別にターゲット商品をカスタマイズし配信
レスポンス良好
- ・**新規顧客発掘強化**
⇒保有しているリードから案件の掘り起こし
専属人員配置



ご注意事項・お問い合わせ先

<ご注意事項>

1. 当資料は投資分析を目的として作成しておりますので、投資分析にのみご使用ください。
2. 2022年3月期の予想は、現時点で得られた情報にもとづいております。従って、業況の変化などにより記載の予想と大きく異なる場合があります。
3. 会計基準の改正に伴う変更は、過去のデータには反映しておりません。

<お問い合わせ先>

ローム株式会社 広報IR室
〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21
E-mail: ir@rohm.co.jp

